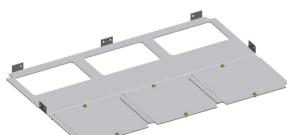


Opis produktu

RB56F1

RB56F1 Bottom plate, Field width: 5, 27.5 mm x 1262 mm x 509 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	RB56F1
Kod zamówieniowy	2CPX045799R9999
Numer EAN	4011617457992
Opis katalogowy	RB56F1 Bottom plate, Field width: 5, 27.5 mm x 1262 mm x 509 mm
Opis	Bottom plate, series TriLine, Modular distribution panel not assembled, Galvanised, dimensions in mm (H x W x D): 27.5 x 1262 x 509, panel width 5, cabinet depth 6

Dane techniczne

Funkcja dodatkowa	with cable entry
Do użytku z	5/10R6/5/10RG6/5/8R6/5/8RG6
Typ obudowy	Bottom plate
Wykończenie pokrywy	Ocynkowany
Materiał	Stal
Liczba modułów do zabudowy	0
Pola pomiarowe	0
Uwagi	ETIM

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100020X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	1262 mm
Wysokość netto	27.5 mm
Głębokość / długość netto	509 mm
Masa netto	7.304 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	7.304 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100020X0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CPC104827M5601
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000744 - Top-/floor element (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC000744 - Top-/floor element (enclosure/cabinet)
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099
eClass	V11.1 : 27182405
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → TriLine-R → Structure

